

古河電気工業(株) 事業 IR 説明会 質疑応答録 (要旨)

日時：2024年6月7日(金) 14:45-15:30

内容：機能製品事業

説明者：執行役員常務 機能製品統括部門長 大野 良次

陪席者：執行役員 AT・機能樹脂事業部門長 矢野 正三

サーマル・電子部品事業部門長 川畑 賢也

メモリーディスク事業部門長 森 高志

銅箔事業部門長 齊藤 孝史

企画統括部長 石川 真樹

執行役員 財務本部長 青島 弘治

Q：半導体製造用テープについて顧客拡大の進展はどのような状況か？また競争環境について教えてほしい。

A：半導体製造用テープに限らず、機能製品においては顧客の拡大は大きなテーマと認識して取り組んでいる。特にこの数年は半導体の製造プロセスが複雑化しており、それを先端プロセスと呼んでいるが、その先端プロセスに対応できる高付加価値品を狙ってスペックインを図り、同様の先端プロセスを導入している他のお客様に横展開することにより顧客の拡大を進めている。これにより、BG テープ（バックグラインドテープ）の分野ではシェアを上げつつある。先端を走っている韓国の半導体メーカーはもちろん、そこから台湾、中国等他地域のお客様へ広げている。

Q：銅箔事業の収益回復に向けた展望は？高周波対応銅箔は日系競合メーカーもいる中、市場環境も含めて収益改善は図れるのか？

A：大容量のデータを高速に、ロスを少なく送ることを求められる高周波対応銅箔は、我々を含む日系メーカーが高い技術を保有しけん引していると認識している。大変難しい技術ではあるが、この分野でいち早く差別化を図り、AI サーバに対応できる高周波対応銅箔の数量を増やして製品ミックスの改善を図ることで収益力の向上に繋げる。24年度の収益にも貢献を見込んでいる。

Q：サーマル製品について、水冷製品も採用が決まっているとのことだが、空冷と同様に優位性が発揮されると期待できるか？

A：冷却方式は、空冷に加え、水冷・液浸と三つ巴の状態になってきていると認識している。当社としては、どの方式にでも対応できるような準備をしている。空冷・水冷・液浸で姿形は違うが、冷やす対象物は半導体であり、そこから熱を奪い運んでいくという基本的な理論は変わらないと考えている。従来の技術の延長線上にあるため、その実績に基づき水冷・液浸でも採用いただけるようになってきている。

Q：競合他社ではコールドプレートを作るにあたり銅粉を使い3D プリンタで製造する技術というものもあるようだが、この技術についての優位性はどのように考えているか？

A : だいぶ先の技術になると思うが、大きなアドバンテージになるとは考えていない。

Q : P20 サーマル・電子部品事業の CAGR の伸びが生成 AI 市場の成長よりも緩やかに見えるが、どのような想定をしているのか？

A : 24 年度の予想を立てる上で最終ユーザとの意見交換も行っているが、その時点では 23 年度に比べて 24 年度以降は 10-15% 増くらいの伸びを想定していた。足元の需要は旺盛なのでこの先もう少し伸びる可能性は否定できない。マーケットの需要をよく見ながら必要に応じて計画はリバイズしていきたい。

Q : 半導体製造用テープの顧客層が拡大しているとのことだったが、この数年では売上・利益ともにそれほど伸びていない。半導体市場の減速が要因なのか？

A : ご認識の通りマーケットの落ち込みが大きかったのが要因である。徐々に回復も見られ始めており、ここから先はそれほど心配していない。

Q : サーマル・電子部品事業について、空冷・水冷・液浸といったマーケット全体での競合環境や御社の立ち位置について教えてほしい。

A : 全体像を語るのは難しく、シェアがどうなっているという見方はしていないが、当社がこの業界の中では上位にいるのは確か。良いポジションにいるので、将来にむけて水冷や液浸のお話もいただけるものと思っている。競合については、水冷や液浸は新しい方式であるためこれまでとは異なる新たな企業も参入を試みている模様。

Q : サーマル・電子部品事業はどのくらい上方弾力性があるか？ 稼働率や増産投資による余力等の観点から教えてほしい。

A : フィリピン・中国とも増産体制をとっており、ほぼフル稼働している。これから先の需要も見ながら、必要に応じて投資を行い需要増に伝えていく。

Q : 機能製品全体の ROIC 向上について考えると、高付加価値な事業への集中という選択肢もあるのではないかと思うが、どのように考えているか？

A : 23 年度は、例えば HDD 用アルミブランク材や銅箔のようにマーケットの状況が非常に厳しい事業もあったが、マーケットが回復することで ROIC の押上に繋がる部分は少なくない。選択と集中という点では AI 関連のマーケットの伸び率が高いのでできるだけ集中はしていこうと思っているが、そこだけに絞ることが中期的にみて正しいとは思っていない。マーケットの状況をよくみながら、利益率の高いところに事業を広げていくというのが我々の考え方。例えば、10 数年前はパソコンが 1 番の主要マーケットだったが、コモディティ化によりレッドオーシャンとなったため注力分野から外すなどポートフォリオを変化させてきた。今 AI 関連が強いかからといってそれ以外を捨てるということは考え

ていない。

Q：銅箔事業は23年度から24年度へ損益改善が計画されているが、すでにAI用途の銅箔は売上に含まれているのか？

A：既に売上に含まれており、今後増えていく。

Q：半導体製造用テープの第2工場が完成したことで、その先どのくらいの需要に対応できると考えているか？

A：24年度の売上増加は下期のマーケット回復によるものであり、既存工場で製造対応する。25年度以降は、3工場体制でしっかりと需要増に応えていく。現在の計画では2030年頃には3工場ともにフルキャパシティでの操業を想定している。2030年度以降の需要増にむけて、さらにキャパシティを整えていくことも検討している。なお、設備増強については、半導体製造用テープのみならず、銅箔、サーマル製品等他の製品でもマーケットの状況をみながら、必要に応じて随時対応する方針。

Q：半導体製造用テープの製造工場が2工場から3工場に増えるとのことだが、製造能力は1.5倍になるイメージでよいか？

A：ご認識のとおり。

Q：半導体製造用テープの増産投資について、着工から2年、25年の量産開始までさらに1年間かかるのはなぜか？

A：製造工場が変わると顧客にとっては品質管理の観点で重要な5M変更となるため、この1年間は顧客認証をいただくための期間である。

(注：5M：Man, Machine, Material, Method, Measurement)

Q：銅箔事業は高付加価値製品を伸ばすことにより収益改善を図るとのことだが、25年度に向けて高付加価値製品のウェイトはどのように変化する計画か？

A：P25の右の図で、下から3段目のH-VLPというグレード以上のものを高付加価値製品としており、その割合は22年度には10%以下だったが、23年度には30%、足元では30-35%まで増えてきている。今後もAIサーバを中心に需要があり24年度には40%を見込む。25年度には全体の50%程度に増やしていく想定。

以上